

部品内蔵基板パッケージにおける熱応力発生要因に関する研究

松浦, 政光

<https://hdl.handle.net/2324/7157363>

出版情報 : Kyushu University, 2023, 博士 (工学), 課程博士
バージョン :
権利関係 :

氏 名	松浦 政光			
論 文 名	部品内蔵基板パッケージにおける熱応力発生要因に関する研究			
論文調査委員	主 査	九州大学	教授	木村 俊二
	副 査	九州大学	教授	加藤 和利
	副 査	九州大学	教授	金谷 晴一

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨

本研究は、一度埋め込んだ半導体チップに対して、チップ裏面の埋め込み樹脂の除去と、キャビティを有したプリプレグを用いることで、世界で初めて中空構造を有する部品内蔵基板を開発し、その部品内蔵基板を用いて、基板内に発生する熱応力の発生要因を特定したものであり、電気電子工学上価値のある業績である。よって博士（工学）の学位に値すると認める。